

中国半导体芯片行业发展现状研究与投资趋势调研报告（2022-2029年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体芯片行业发展现状研究与投资趋势调研报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202209/610698.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体芯片是指在半导体片材上进行浸蚀、布线、制成的能实现某种功能的半导体器件，通常也可称为集成电路。半导体芯片产业是我国科技自立和经济高质量增长的重要驱动力，不仅自身存在巨大的增长前景，更为重要的是芯片是人工智能、汽车电子、物联网、大数据、云计算、区块链等新兴产业发展的基础构件。

一、行业发展现状

半导体芯片归属于半导体产业。而半导体产业是国家信息产业的基石，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。

为推动半导体产业发展，打破国外垄断，增强产业创新能力和国际竞争力。近年国家从关键技术研发、产业应用等角度大力支持促进行业发展。例如2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。

近年来有关半导体相关政策情况

发布时间

文件名称

发布单位

主要内容

2022-03

《关于做好2022年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》

发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局

重点集成电路设计领域:高性能处理器和FPGA芯片3存储芯片;智能传感器;工业、通信、汽车和安全芯片、EDA、IP和设计服务。如业务范围涉及多个领域,仅选择其中一个领域进行申请,选择领域的销售(营业收入占本企业集成电路设计销售《营业》收入的比例不低于50%。

2021-12

《“十四五”数字经济发展规划》

国务院

在“数字技术创新突破工程”方面,提出要抢先布局前沿技术融合创新,推进前沿学科和交叉研究平台建设,重点布局下一代移动通信技术,量子信息、第三代半导体等新兴技术,推动信息、生物、材料、能源等领域技术融合和群体性突破。

2021-11

《“十四五”信息通信行业发展规划》

工信部

要完善数字化服务应用产业生态，加强产业链协同创新。军富5芯片、终端、模组、网关等产品种类，加快推动面向行业的5面芯片、模组、终端、网关等产品研发和产业化进程，推动芯片企业丰富产品体系，加快模组分级分类研发，优化模组环境适应性，持续降低功耗及成本，增强原始创新能力和产亚基础支撑能力。

2021-09

《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》

工信部、科技部等八部门

高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升。突破MEMS传感器和物联网芯片的设计与制造

2021-03

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

国务院

瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化

2021-01

《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》

工信部

重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件，温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器，新型MEMS传感器和智能传感器，微型化、智能化的电声器件

2020-09

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》

国家发改委、科技部、工信部、财政部

加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用

2020-07

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

国务院

聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、集成电路关键材料、集成电路设计工具、基础软件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制

2019-11

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

国家发改委

将集成电路设计，线宽0.8微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试列为鼓励类产业

2019-10

《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》

工信部、国家发改委、财政部等十三部委

在电子信息领域，大力发展集成电路设计，大型计算设备设计，个人计算机及智能终端设计，人工智能时尚创意设计，虚拟现实/增强现实（VR/AR）设备、仿真模拟系统设计等

2017-12

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》

工信部

发展市场前景广阔的新型生物、气体、压力、流量、惯性、距离、图像、声学等智能传感器，推动压电材料、磁性材料、红外辐射材料、金属氧化物等材料技术革新，支持基于微机电系统（MEMS）和互补金属氧化物半导体（CMOS）集成等工艺的新型智能传感器研发，发展面向新应用场景的基于磁感、超声波、非可见光、生物化学等新原理的智能传感器，推动智能传感器实现高精度、高可靠、低功耗、低成本

2017-11

《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）》

工信部

补齐设计、制造关键环节短板，推进智能传感器向中高端升级；面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域，开展智能传感器应用示范；建设智能传感器创新中心，进一步完善技术研发、标准、知识产权、检测等公共服务能力，助力产业创新发展；合理规划布局，进一步完善产业链，促进产业集聚发展

资料来源：观研天下整理

随着下游应用行业快速发展，稳定的经济增长以及在有利的政策等背景下，近年我国半导体产业规模得到迅速发展。到目前我国已成为了全球需求最大的半导体市场。数据显示，2021年我国半导体销售规模从2015年的986亿美元增长至1925亿美元，年均复合增速为11.8%

。

数据来源：观研天下整理

目前我国正处在由制造业转向尖端工业化的进程中，产业智能化、信息化已经成为国家发展

的重要方向，作为电子系统的“粮仓”、数据信息的载体，芯片在保证重要信息存储的可靠性与安全性承担着关键作用，但目前我国芯片自给率较低，中高端芯片均通过进口获取，随着中美贸易摩擦频繁，掌握自主可控存储技术的重要性逐步凸显，未来国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升，将带来我国半导体产业的新发展机遇，从而也将给半导体芯片市场带来发展机遇。

在上述背景下，近年我国半导体芯片市场规模呈现持续快速上升的态势。根据数据显示，2021年我国半导体芯片市场规模从2017年的5411亿元增长至10458亿元，年均复合增长率约为17.9%。

数据来源：观研天下整理

企业数量不断增加。数据显示，2020年我国芯片相关企业注册量新增2.31万家，同比增长173.76%。2021年我国芯片相关企业注册量新增4.74万家，同比增长105.06%。

数据来源：企查查，观研天下整理

二、行业融资市场

近年来随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展，不少投资人将资本瞄准了芯片半导体领域。2011-2021年我国芯片半导体投融资事件数整体上呈上升趋势。数据显示，2021年我国芯片半导体行业获得资本融资686起；获得投融资金额2013.74亿元；截止2022年上半年我国芯片半导体行业获得资本融资318起；获得投融资金额797.46亿元。

数据来源：IT桔子，观研天下整理

数据来源：IT桔子，观研天下整理（WW）

观研报告网发布的《中国半导体芯片行业发展现状研究与投资趋势调研报告（2022-2029年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协

会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【目录大纲】

第一章 2018-2022年中国半导体芯片行业发展概述

第一节 半导体芯片行业发展情况概述

一、半导体芯片行业相关定义

二、半导体芯片特点分析

三、半导体芯片行业基本情况介绍

四、半导体芯片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、半导体芯片行业需求主体分析

第二节 中国半导体芯片行业生命周期分析

一、半导体芯片行业生命周期理论概述

二、半导体芯片行业所属的生命周期分析

第三节 半导体芯片行业经济指标分析

一、半导体芯片行业的赢利性分析

二、半导体芯片行业的经济周期分析

三、半导体芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2018-2022年全球半导体芯片行业市场发展现状分析

第一节 全球半导体芯片行业发展历程回顾

第二节 全球半导体芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲半导体芯片行业地区市场分析

- 一、亚洲半导体芯片行业市场现状分析
- 二、亚洲半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲半导体芯片行业市场前景分析
- 第四节北美半导体芯片行业地区市场分析
 - 一、北美半导体芯片行业市场现状分析
 - 二、北美半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美半导体芯片行业市场前景分析
- 第五节欧洲半导体芯片行业地区市场分析
 - 一、欧洲半导体芯片行业市场现状分析
 - 二、欧洲半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧洲半导体芯片行业市场前景分析
- 第六节 2022-2029年世界半导体芯片行业分布走势预测
- 第七节 2022-2029年全球半导体芯片行业市场规模预测

第三章 中国半导体芯片行业产业发展环境分析

- 第一节我国宏观经济环境分析
- 第二节我国宏观经济环境对半导体芯片行业的影响分析
- 第三节中国半导体芯片行业政策环境分析
 - 一、行业监管体制现状
 - 二、行业主要政策法规
 - 三、主要行业标准
- 第四节政策环境对半导体芯片行业的影响分析
- 第五节中国半导体芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国半导体芯片行业运行情况

- 第一节中国半导体芯片行业发展状况情况介绍
 - 一、行业发展历程回顾
 - 二、行业创新情况分析
 - 三、行业发展特点分析
- 第二节中国半导体芯片行业市场规模分析
 - 一、影响中国半导体芯片行业市场规模的因素
 - 二、中国半导体芯片行业市场规模
 - 三、中国半导体芯片行业市场规模解析
- 第三节中国半导体芯片行业供应情况分析
 - 一、中国半导体芯片行业供应规模

二、中国半导体芯片行业供应特点

第四节中国半导体芯片行业需求情况分析

一、中国半导体芯片行业需求规模

二、中国半导体芯片行业需求特点

第五节中国半导体芯片行业供需平衡分析

第五章 中国半导体芯片行业产业链和细分市场分析

第一节中国半导体芯片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、半导体芯片行业产业链图解

第二节中国半导体芯片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对半导体芯片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对半导体芯片行业的影响分析

第三节我国半导体芯片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国半导体芯片行业市场竞争分析

第一节中国半导体芯片行业竞争现状分析

一、中国半导体芯片行业竞争格局分析

二、中国半导体芯片行业主要品牌分析

第二节中国半导体芯片行业集中度分析

一、中国半导体芯片行业市场集中度影响因素分析

二、中国半导体芯片行业市场集中度分析

第三节中国半导体芯片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国半导体芯片行业模型分析

第一节中国半导体芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国半导体芯片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国半导体芯片行业SWOT分析结论

第三节中国半导体芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022年中国半导体芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国半导体芯片行业市场动态情况

第二节中国半导体芯片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节半导体芯片行业成本结构分析

第四节半导体芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国半导体芯片行业价格现状分析

第六节中国半导体芯片行业平均价格走势预测

- 一、中国半导体芯片行业平均价格趋势分析
- 二、中国半导体芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国半导体芯片行业所属行业运行数据监测

第一节中国半导体芯片行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节中国半导体芯片行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

第三节中国半导体芯片行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第十章 2018-2022年中国半导体芯片行业区域市场现状分析

第一节中国半导体芯片行业区域市场规模分析

- 一、影响半导体芯片行业区域市场分布的因素
- 二、中国半导体芯片行业区域市场分布

第二节中国华东地区半导体芯片行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区半导体芯片行业市场分析
 - (1) 华东地区半导体芯片行业市场规模
 - (2) 华南地区半导体芯片行业市场现状
 - (3) 华东地区半导体芯片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区半导体芯片行业市场分析
 - (1) 华中地区半导体芯片行业市场规模

(2) 华中地区半导体芯片行业市场现状

(3) 华中地区半导体芯片行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区半导体芯片行业市场分析

(1) 华南地区半导体芯片行业市场规模

(2) 华南地区半导体芯片行业市场现状

(3) 华南地区半导体芯片行业市场规模预测

第五节 华北地区半导体芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区半导体芯片行业市场分析

(1) 华北地区半导体芯片行业市场规模

(2) 华北地区半导体芯片行业市场现状

(3) 华北地区半导体芯片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区半导体芯片行业市场分析

(1) 东北地区半导体芯片行业市场规模

(2) 东北地区半导体芯片行业市场现状

(3) 东北地区半导体芯片行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区半导体芯片行业市场分析

(1) 西南地区半导体芯片行业市场规模

(2) 西南地区半导体芯片行业市场现状

(3) 西南地区半导体芯片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区半导体芯片行业市场分析

(1) 西北地区半导体芯片行业市场规模

(2) 西北地区半导体芯片行业市场现状

(3) 西北地区半导体芯片行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国半导体芯片行业市场规模区域分布预测

第十一章 半导体芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029年中国半导体芯片行业发展前景分析与预测

第一节中国半导体芯片行业未来发展前景分析

- 一、半导体芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体芯片行业市场机会分析
- 三、中国半导体芯片行业投资增速预测

第二节中国半导体芯片行业未来发展趋势预测

第三节中国半导体芯片行业规模发展预测

- 一、中国半导体芯片行业市场规模预测
- 二、中国半导体芯片行业市场规模增速预测
- 三、中国半导体芯片行业产值规模预测
- 四、中国半导体芯片行业产值增速预测
- 五、中国半导体芯片行业供需情况预测

第四节中国半导体芯片行业盈利走势预测

第十三章 2022-2029年中国半导体芯片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国半导体芯片行业进入壁垒分析

- 一、半导体芯片行业资金壁垒分析
- 二、半导体芯片行业技术壁垒分析
- 三、半导体芯片行业人才壁垒分析
- 四、半导体芯片行业品牌壁垒分析
- 五、半导体芯片行业其他壁垒分析

第二节半导体芯片行业风险分析

- 一、半导体芯片行业宏观环境风险
- 二、半导体芯片行业技术风险
- 三、半导体芯片行业竞争风险
- 四、半导体芯片行业其他风险

第三节中国半导体芯片行业存在的问题

第四节中国半导体芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2022-2029年中国半导体芯片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国半导体芯片行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节中国半导体芯片行业进入策略分析

- 一、目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节 半导体芯片行业营销策略分析

- 一、半导体芯片行业产品策略
- 二、半导体芯片行业定价策略
- 三、半导体芯片行业渠道策略
- 四、半导体芯片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202209/610698.html>